

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	诺安基金、银河基金、国泰基金、兴合基金、宏利基金、高竹基金、中庚基金、小红书投资、箫峰基金、真科基金、中银三星人寿、国华兴益保险、太保资产、睿郡资产、健顺投资、江苏沚沃私募基金管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海咏明资产管理有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、武汉言是科技有限公司、上海森锦投资管理有限公司、上海渊泓投资管理有限公司、深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海明河投资管理有限公司、江西彼得明奇私募基金、达诚基金管理有限公司、青骊投资、上海启览资产管理有限公司、鹤禧投资、弥远投资、石泉投资、领伟资本、上海市益和源资产管理有限公司、丹羿投资、华创资管、广发证券、华源证券、信达证券、爱建证券、国信证券、瑞银证券、东兴证券、西南证券、申万宏源证券、中泰证券、国盛证券、长城证券、长江证券、东北证券、中信建投证券、申万宏源、西部证券、华安证券、国金证券、中金公司、国投证券、东方财富证券、国泰海通证券、国泰海通、浙商证券、甬兴证券、国海证券、山西证券、西部自营、前海开源、中邮证券等 67 家机构
时间	2026 年 5 月 11 日
地点	现场交流
公司接待人员	1、董事会秘书、财务总监 陆春龙

	<p>2、证券事务代表 李妍君</p> <p>3、子公司 LUCEDA NV 总裁 曹如平</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、公司概况</p> <p>广立微是领先的 EDA 软件、PDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，聚焦芯片成品率提升与电性测试快速监控业务，同时布局光子芯片设计技术，是国内外多家大型集成电路企业的重要合作伙伴。公司提供 EDA 软件、PDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备及成品率提升全流程解决方案，贯穿集成电路设计至量产全周期，助力提升芯片性能、成品率与稳定性，成功案例覆盖多个集成电路先进工艺节点。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司在硅光领域的核心优势是什么？</p> <p>公司目前在硅光领域的优势主要有 Luceda 的先发优势与前瞻技术积累、全流程的协同能力以及软硬结合的独特壁垒。</p> <p>第一，技术路线上，Luceda 的系列产品实现了从器件设计、链路仿真到版图生成的全流程自动化，同时支持硅光、氮化硅、磷化铟、薄膜铌酸锂等多种材料体系，能够灵活适应不同应用场景。平台还内置了与其他 EDA/PDA 工具的深度对接接口，为光电协同设计奠定了坚实基础。</p> <p>第二，全流程协同能力是广立微区别于多数纯设计工具厂商的关键。Luceda 与广立微的整合，将打通设计工具、晶圆级测试与良率数据分析，形成“设计-制造-测试”的闭环。端到端的集成有助于缩短流片迭代周期，真正践行“一次性设计成功”的愿景。</p> <p>第三，软硬结合方面，我们在持续优化软件工具的同时，积极布局硅光测试硬件设备。依托广立微在电芯片测试领域积累的能力，我们正在研发针对硅光的测试设备。软件与硬件的相互赋能、促进迭代，使我们能够为客户提供更优更高效的设计到量产一体化方案。</p> <p>2、硅光行业目前发展进展如何，有哪些痛点？</p>

硅光行业当前正处于从实验室探索向大规模量产快速过渡的关键阶段。过去几年，随着 AI 算力中心对高带宽、低功耗互连需求的爆发，硅光技术完成了从可插拔光模块到共封装光学（CPO）、光互连（OIO）的架构演进。单通道速率已向 200G 甚至更高跨越，集成度不断提升，多家主流算力平台厂商开始将硅光引擎直接集成到计算系统中。全球范围内，主要晶圆厂纷纷推出硅光工艺平台，制造能力逐步成熟。与此同时，产业发展初期全链路成熟度不高，仍存在较多待突破问题。

第一，生态系统尚未成熟，光芯片设计与制造、检测环节之间存在明显脱节。相比成熟的电芯片产业，硅光领域设计阶段缺乏对制造可行性和检测良率的有效反馈机制：设计师难以预知某个版图结构在实际流片后会出现哪些工艺偏差或缺陷，而制造和检测环节积累的数据也无法高效反哺到设计优化中，此外量产级检测方法、缺陷识别标准、专用测试设备也尚未形成完整体系。这种“设计-制造-检测”的割裂，导致从首次流片到稳定量产需要多次迭代，时间和成本大幅增加。

第二，光芯片与电芯片的设计分离，难以实现真正的协同优化。在传统流程中，光路和电路往往由不同团队使用不同工具独立完成设计，然后在系统集成阶段进行联调。随着 CPO/OIO 将光引擎与电芯片紧密封装甚至单片集成，光与电之间的耦合问题变得极为突出。分离式设计流程无法在早期准确评估这些相互影响，若在流片或封装后才暴露出问题，将导致项目延期甚至失败。光电协同设计（EPDA）工具和统一数据模型的需求日益迫切。

广立微与 **luceda** 联手，针对上述痛点问题，聚焦光电融合场景需求，解决工具链破碎的问题；将光、电、热引入光电系统级设计和优化，解决 CPO 场景下的系统设计挑战；致力于构建“设计—制造—测试—数据”新底座，使得设计感知制造，助力硅光实现规模化量产。

3、Luceda 的客户类型有哪些？

Luceda 的客户群体主要包括光芯片与模块设计公司、集成

	<p>器件制造商（IDM）和代工厂（Foundry）、云服务和算力厂商、新兴应用领域的创新企业以及科研院所和高校。</p> <p>4、Luceda 主要提供哪些产品？业务模式有哪些？</p> <p>Luceda 主要提供两大类产品与服务。第一类是光子设计自动化平台软件，可以在公司软件中实现光电子芯片设计开发全流程。第二类是 PDK 开发与运维服务，主要帮助晶圆厂或 IDM 客户构建标准化的硅光工艺设计套件，包括器件模型库、设计规则文件、验证脚本等，使得客户的设计能够顺利在特定工艺平台上实现高良率流片。此外，Luceda 还提供针对特定项目的技术支持和设计咨询服务。总体而言，Luceda 的产品主要为硅光产业链提供高效、可靠、可扩展的设计基础设施，帮助各类客户缩短产品上市周期、降低流片风险。</p> <p>业务模式方面，第一是软件授权业务，目前是最主要的业务模式，即以许可使用权的形式向客户销售软件工具。第二种是软件技术开发项目制，为客户提供定制化的 PDK 开发、设计流程优化等服务。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2026 年 5 月 11 日